

### 关键指标

频率：0.38~8GHz  
 插入损耗：0.2dB  
 限幅电平：18dBm (max)  
 输入/输出驻波：1.2/1.2  
 耐功率：1W (CW)  
 芯片尺寸：1.03mm×0.6mm

### 产品简介

HG124X2 是一款 GaAs MMIC 限幅器芯片，其插入损耗在其工作频带内小于 0.2dB，端口驻波小于 1.2，该芯片体积小，输入输出端口无隔直电容。

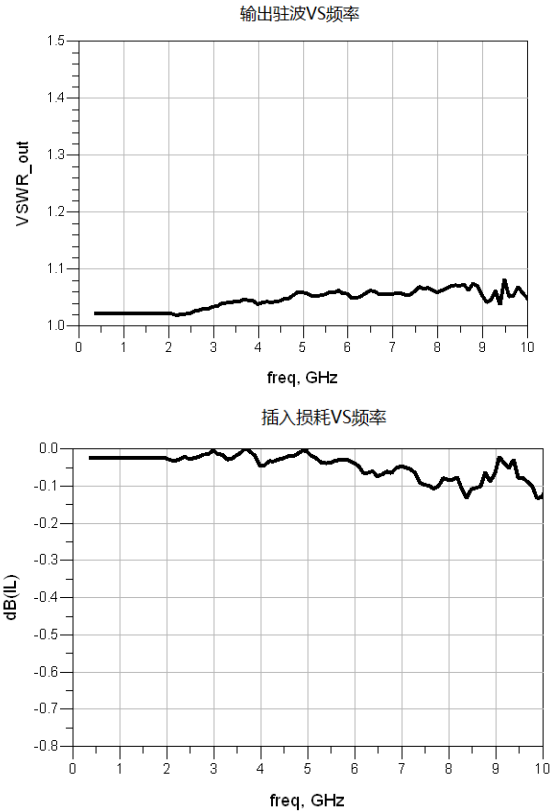
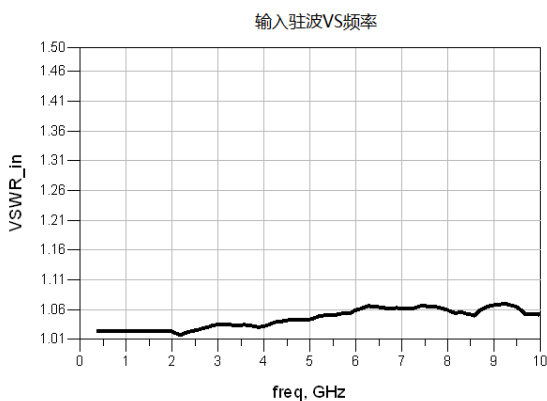
### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	0.38~8		
插入损耗(dB)	—	0.2	—
输入/输出驻波	—	1.2	—
限幅电平(dBm)	—	18	—

### 限幅电平 VS 频点

频率 (GHz)	限幅电平@1W (dBm)
0.38	17.8
2	18
4	17.7
6	10
8	10.3

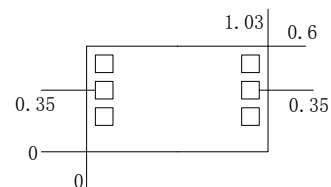
### 典型测试曲线



### 绝对额定最大值

最大输入功率	+30dBm (CW)
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

### 外形和端口尺寸 (mm)



### 推荐装配图



注：芯片内部未集成隔直电容。

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。